

令和7年7月24日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム

半導体製造センシング・実装技術WG

主査 日下 靖之

副査 岩崎 渉、坂田 義太郎、竹井 裕介

令和7年度 第1回 半導体製造センシング・実装技術WGのご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本WGでは、次世代パッケージング技術やその製造・検査等におけるスマートセンシング、インフォマティクス融合など、半導体製造センシング・実装技術に関し、情報共有と議論を通して技術開発要素の課題抽出やプロジェクト提案・実施を目指します。今回は、つくば東地区に新設された後工程関連拠点のご見学と講演会・交流検討会を企画しています。ご出席宜しくお願い致します。8月19日(火)までに参加のご意向をご連絡いただけますと幸いです。

敬具

記

日時：2025年8月26日(火) 13:30～17:00 (13:15受付)

会場：産業技術総合研究所つくば東地区(https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/east/tsukuba_map_e.html)

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| 13:25 | 産業技術総合研究所つくば東地区 東 1-B 受付ロビー集合 | |
| 13:30～13:45 | 開会挨拶、参加者様の簡単な自己紹介 (東本館(1B 棟)1階第2会議室) | 半導体製造センシング・実装技術 WG 主査 日下靖之 |
| 13:45～14:00 | 本日のご見学先についてのご説明 | 半導体製造センシング・実装技術 WG 副査 竹井裕介 |
| 14:00～14:40 | ご見学(本年度新設された次世代パッケージング拠点) | 半導体製造センシング・実装技術 WG 副査 竹井裕介 |
| 14:40～15:00 (休憩) | | |
| 15:00～16:00 (講演 50 分＋質疑 10 分) | 招待講演「半導体中工程・後工程に関する最新動向に関する話題提供(仮)」 | ニシダエレクトロニクス実装技術支援 西田秀行氏 様 |
| 16:00～16:55 | 交流検討会
※ ハイブリッド機能集積研究部門 小林健 研究総括主幹からの話題提供等を交えながら、
ワーキンググループとして検討を深めるべき方向性を探る機会といたします。 | |
| 16:55～17:00 | 閉会挨拶、事務連絡等 | 半導体製造センシング・実装技術 WG 主査 日下靖之 |
| 17:30～ | つくば駅周辺にて懇親会(事前アンケートにてご出欠を伺います) | |

※プログラムは変更する可能性があります。またこのシンポジウムの開催に関して収集した個人情報は今後のシンポジウムご案内ほか、コンソーシアム活動及びセンシング技術研究部門の広報活動に限定して活用させていただきます。

お問い合わせ先：半導体製造センシング・実装技術 WG 事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

E-mail: M-stri-SenTePack-smapack-ml@aist.go.jp